



# Company prospectus

**O-TEC**  
Ohmura "The Technical Experts"

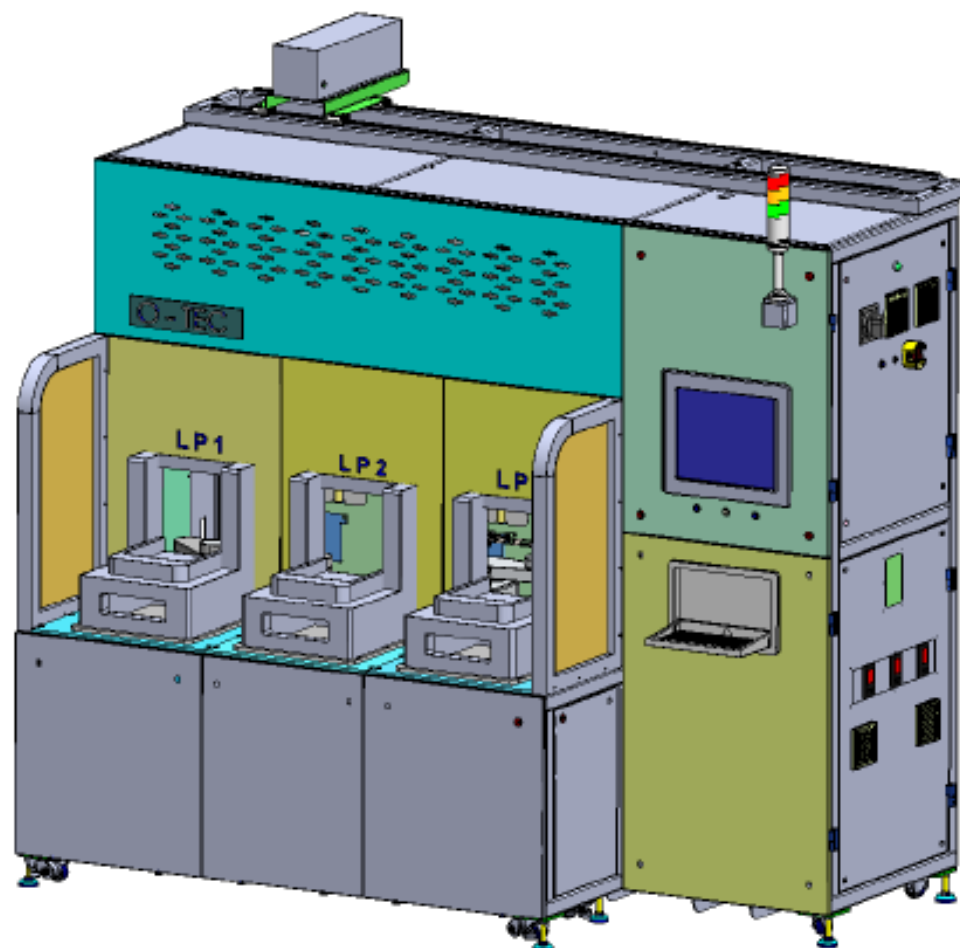
<http://www.otec-jp.com>

**O-TEC** 大村技研株式会社  
Ohmura "The Technical Experts"

**TKS** 販売代理店  
ティー・ケイ・エス株式会社

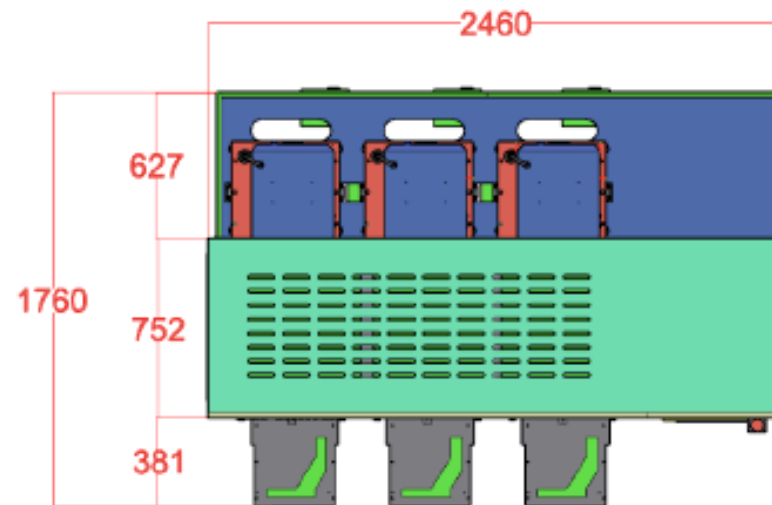
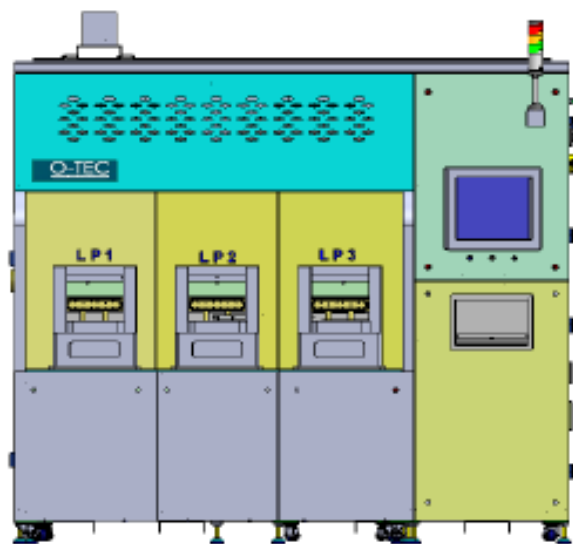
## 枚葉PR除去装置

# 装置仕様

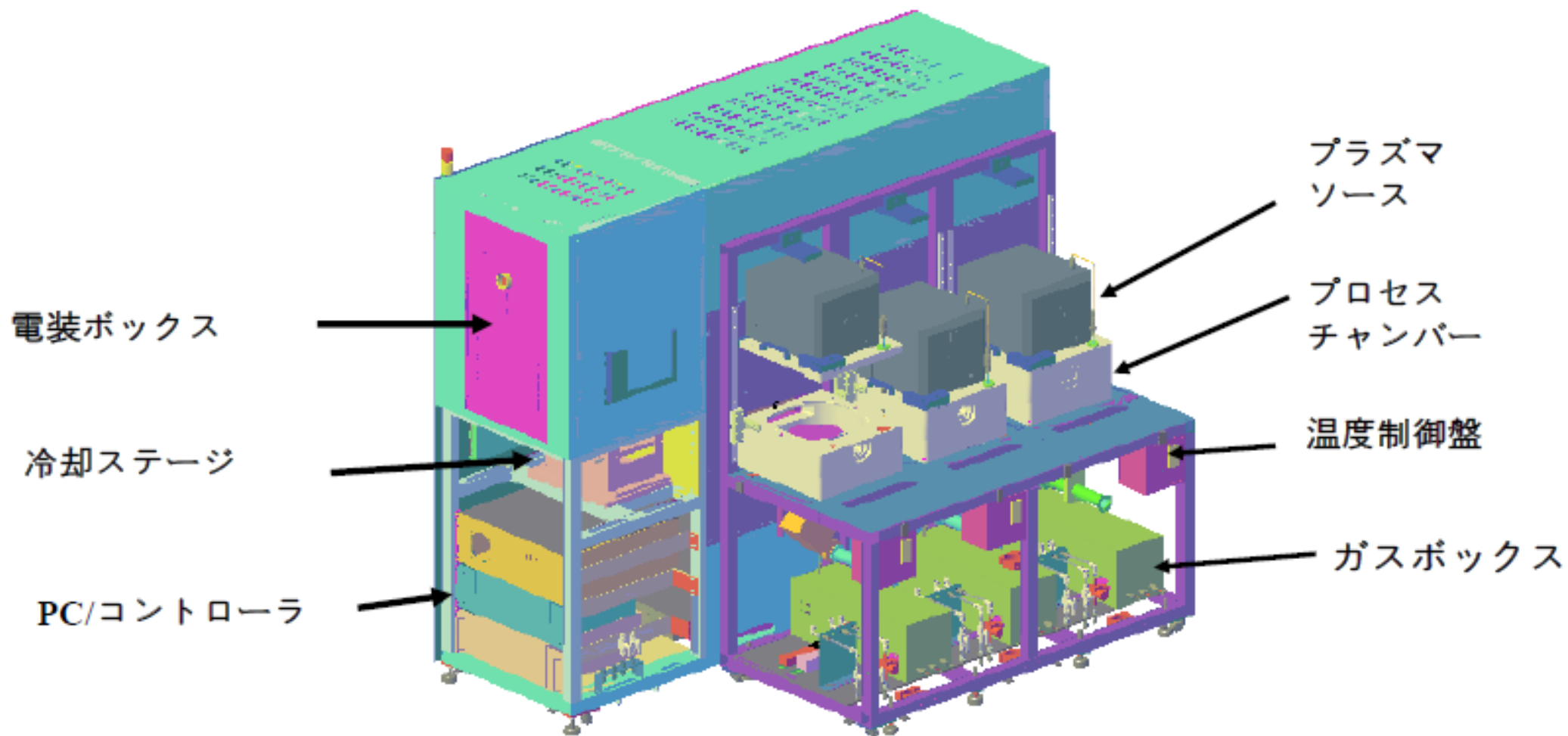


- フットプリント (3SMIFx3PM)
  - D1760 x W2460mm
- 処理能力(3PM)
  - >150枚/時間(30秒工程時間)
- コントロールユニット
  - PLCコントロール
  - デバイスネット
- EFEM
  - 3 SMIF (standard)/カセット
  - デュアルアームエンドイフェクト
  - 多層冷却ステージ
- プロセスチャンバーモジュール
  - リモートプラズマソース
  - 温度制御 (60-250°C)
  - ウェーハヒータチャック
  - イージーメンテナンス
  - 最小限のプロセスキット
- 自動化
  - SECS-GEM/HSMS / OHT対応

## 装置レイアウト



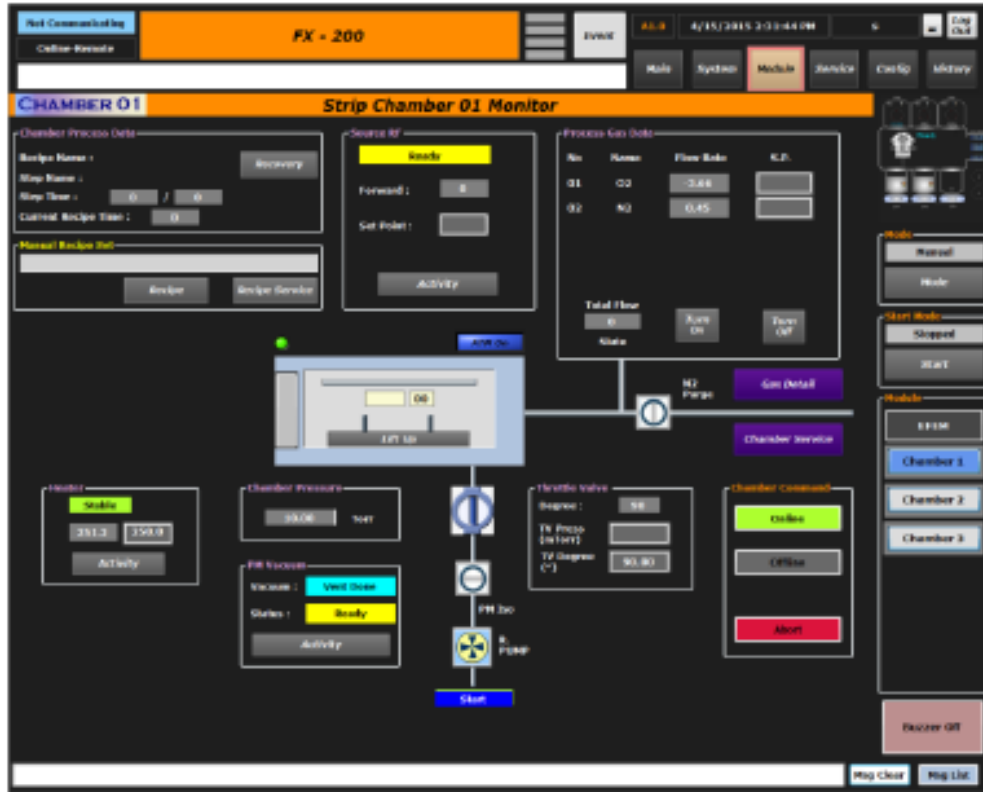
# 装置仕様



# 量産装置



# 装置モニター



チャンバモニター画面

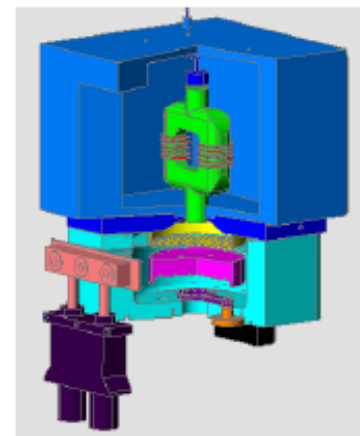
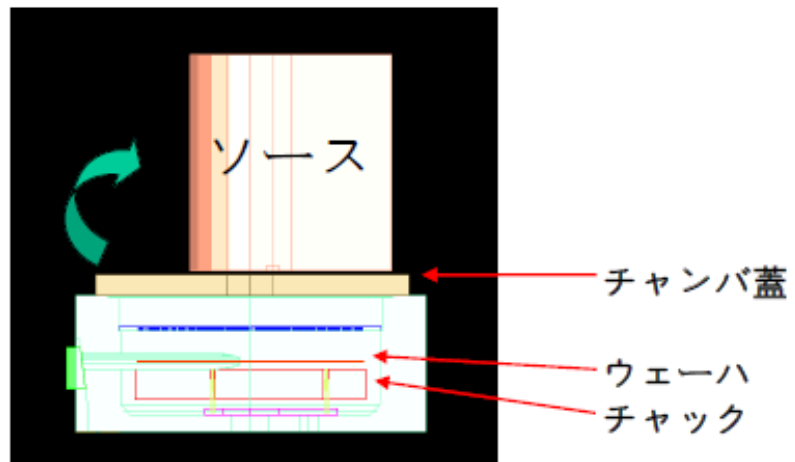


ウェーハモニター画面

# プロセスチャンバ



## プロセスチャンバ& プラズマソース

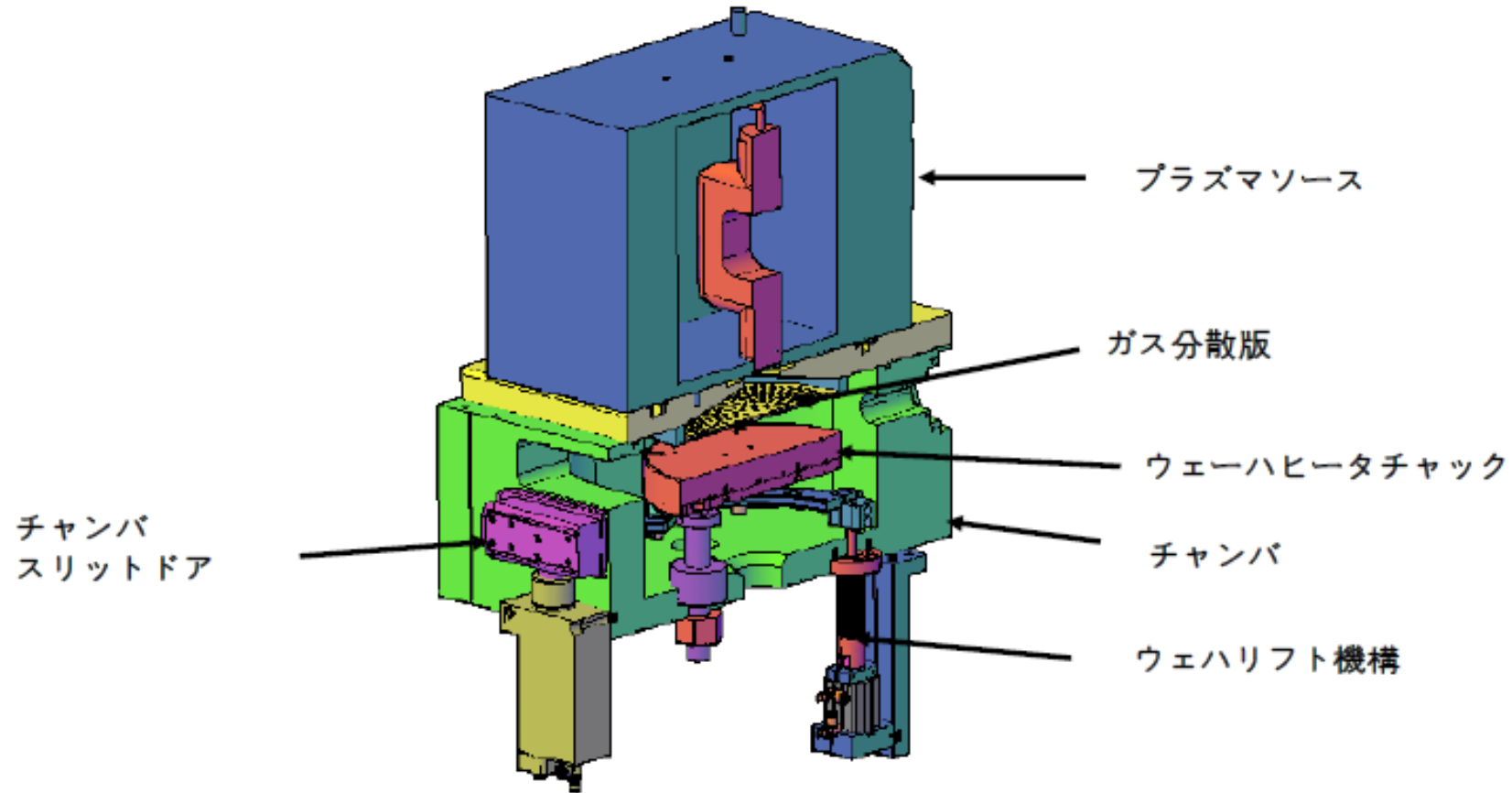


チャンバ & ソース概略図

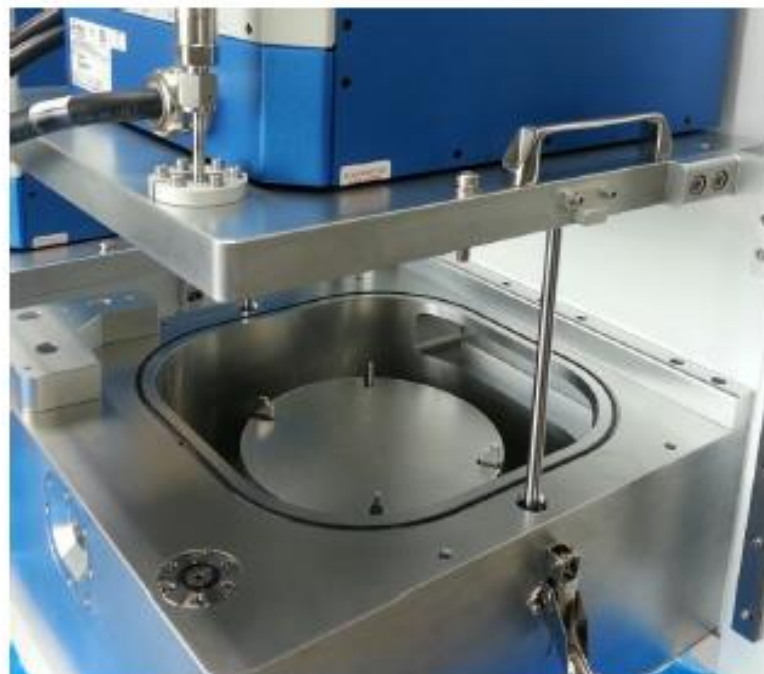
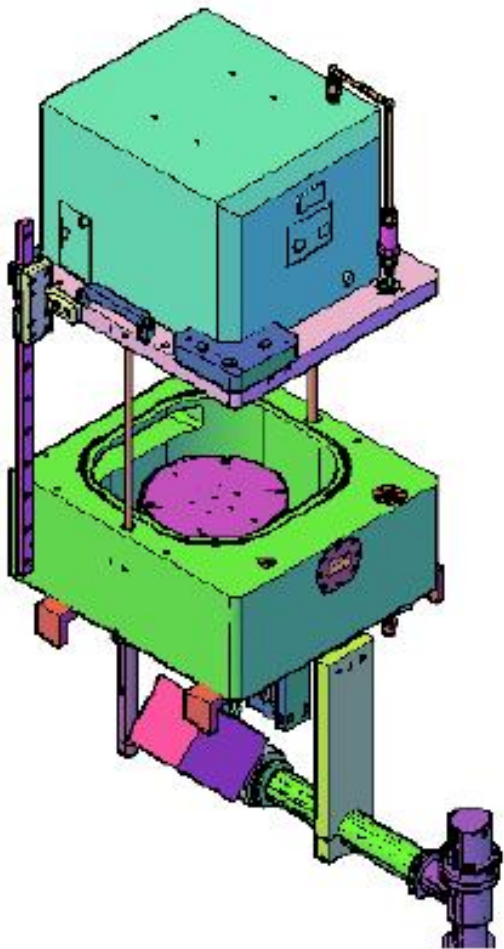
### プロセスチャンバコンセプト

- 最小限のプロセスキット
- イージーメンテナンス
- 均一ガス分布
- 高密度リモートプラズマソース
- ダメージフリープラズマソース

# プロセスチャンバ概略図

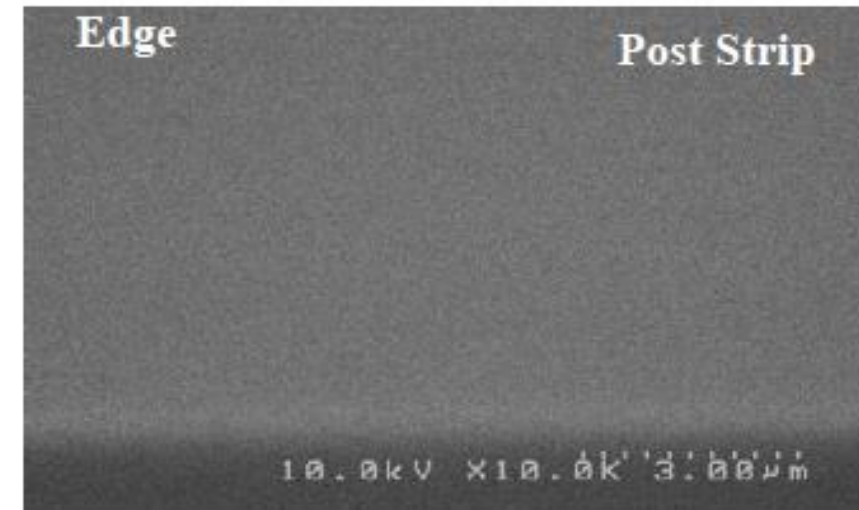
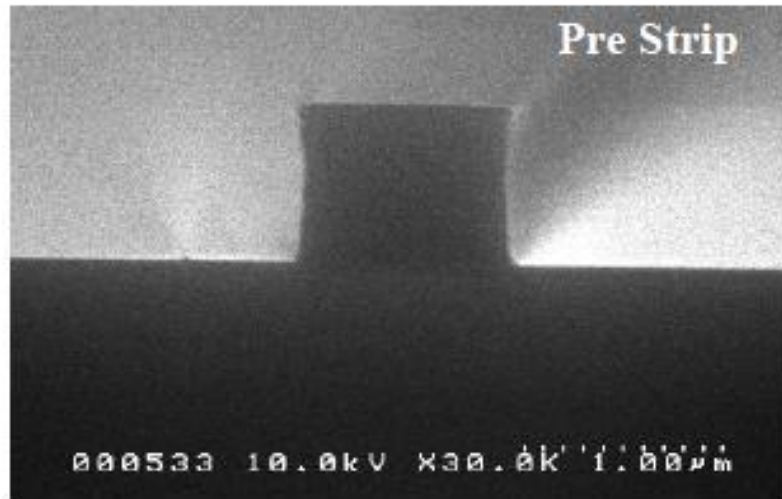
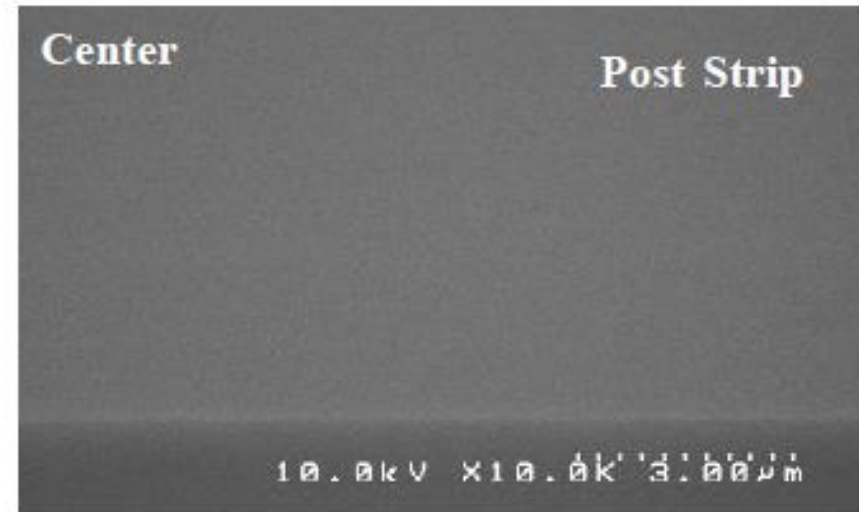
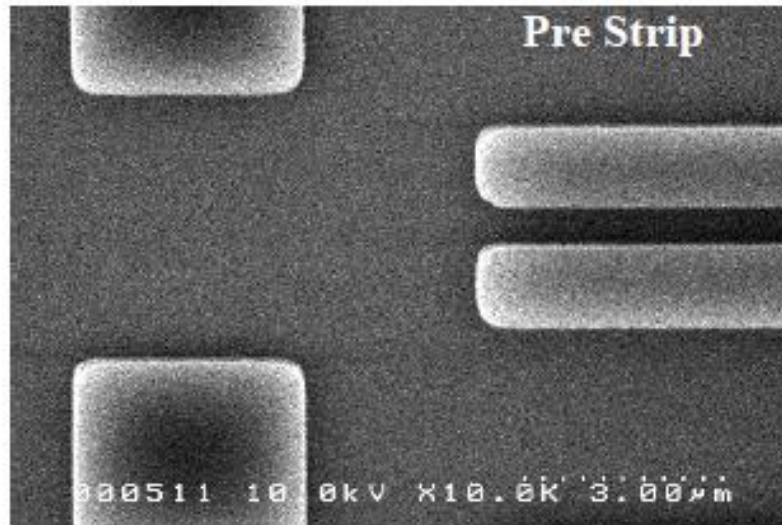


# プロセスチャンバOpen状態

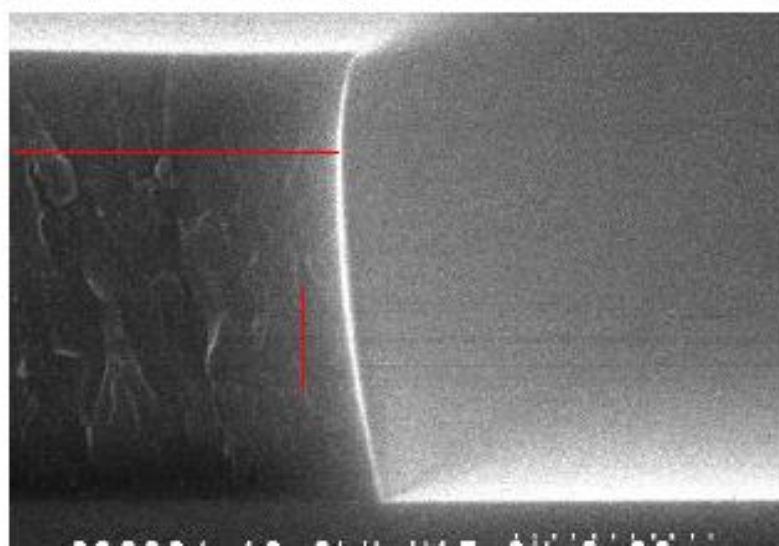
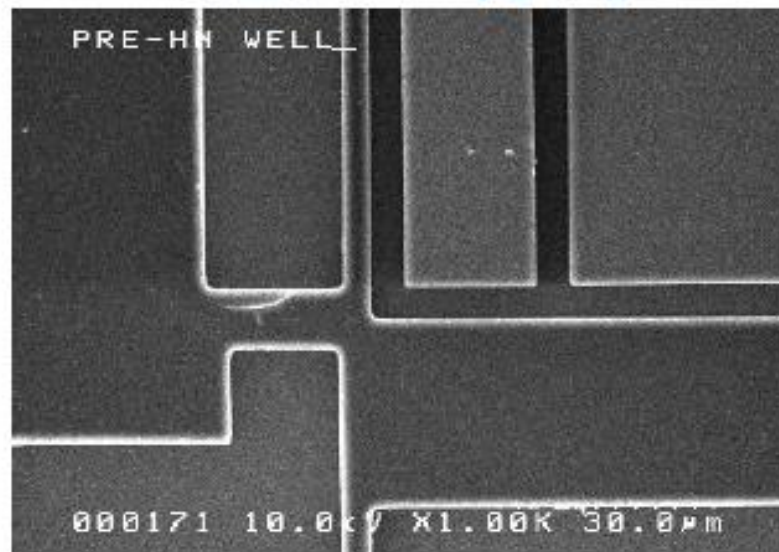


# プロセスデータ

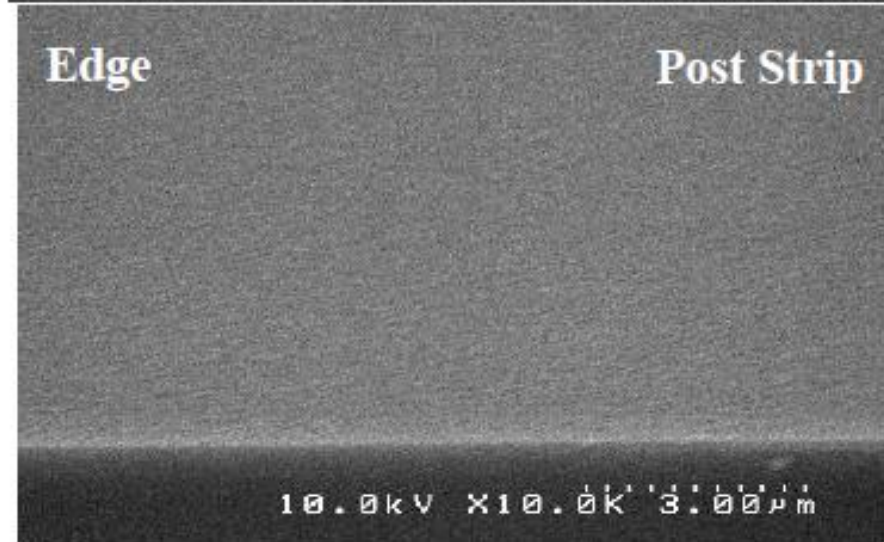
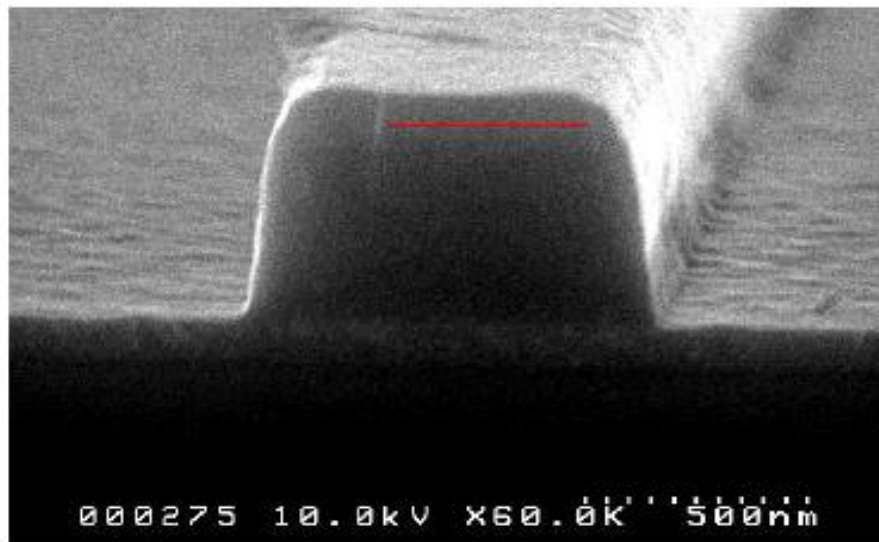
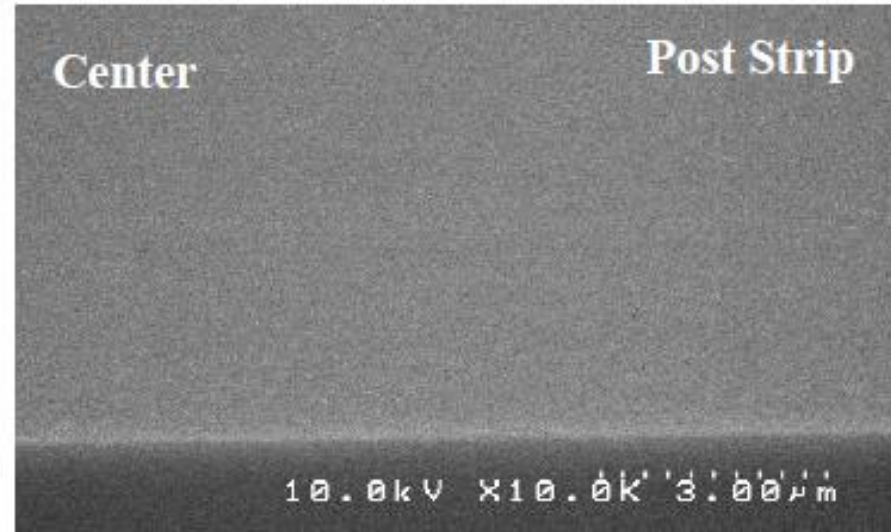
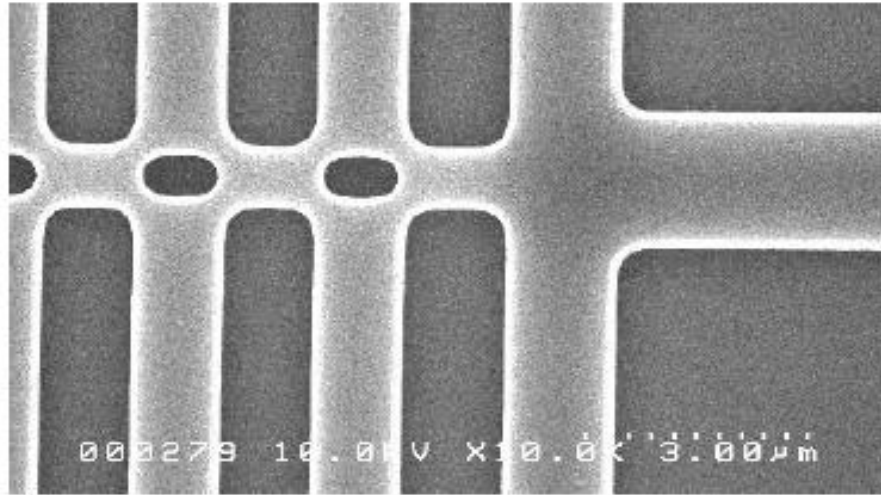
# イオン注入PR除去：Block PR



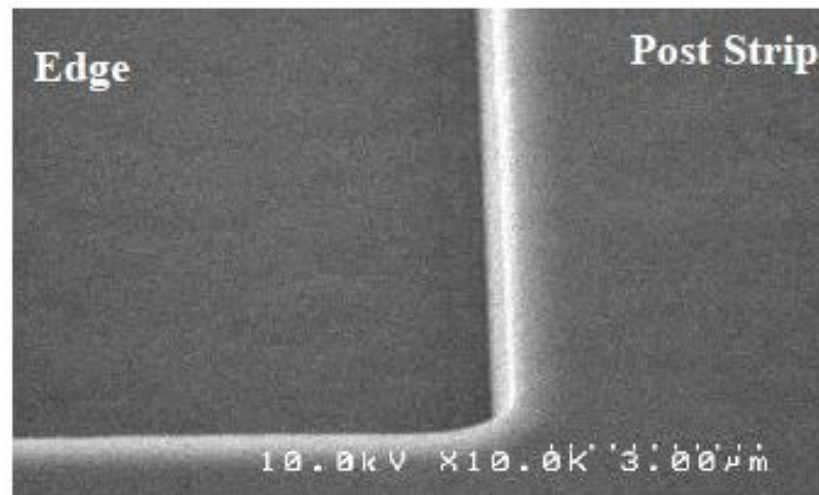
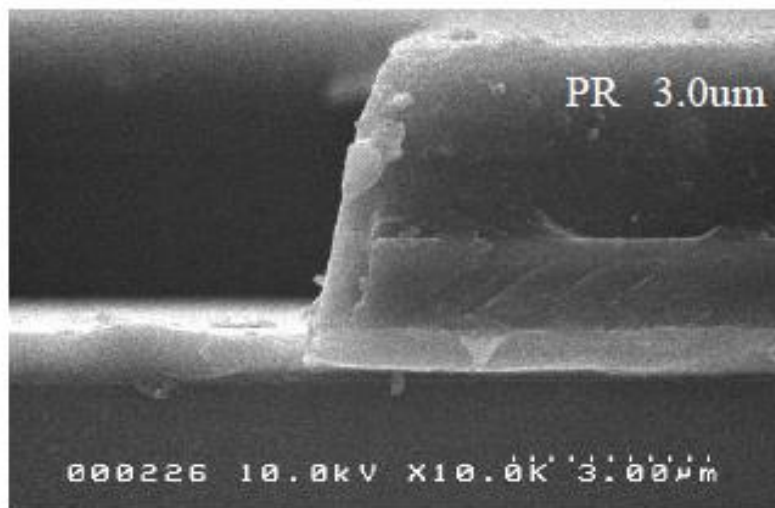
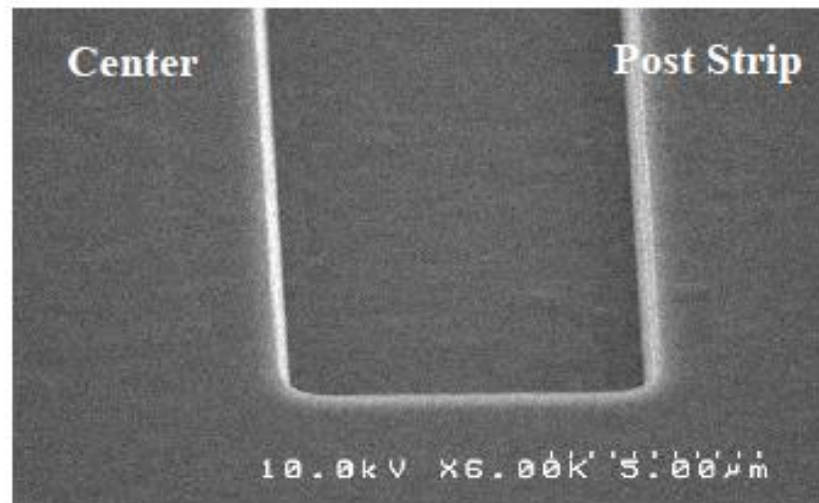
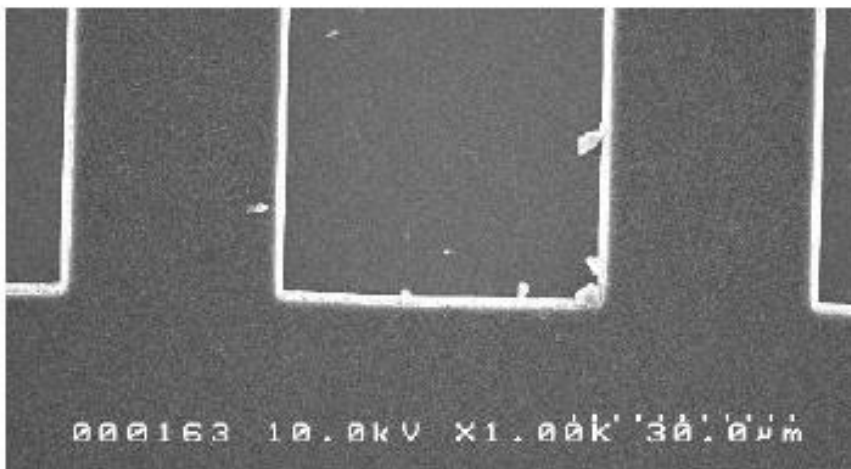
# イオン注入PR除去：HN Well



# イオン注入PR除去：Poly

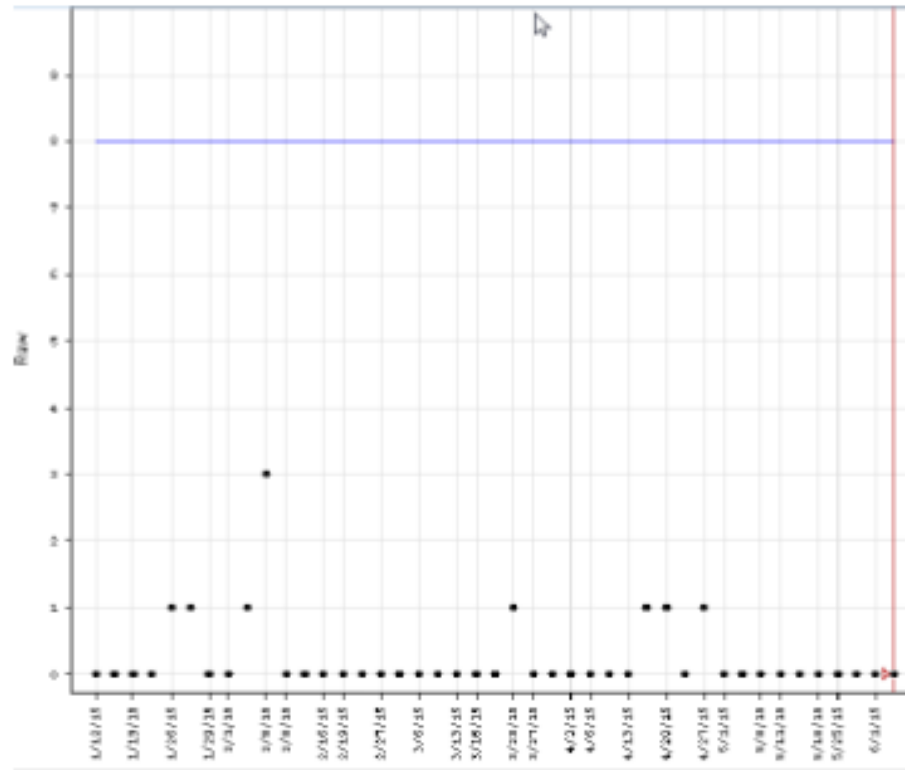


# PR除去 : PAD

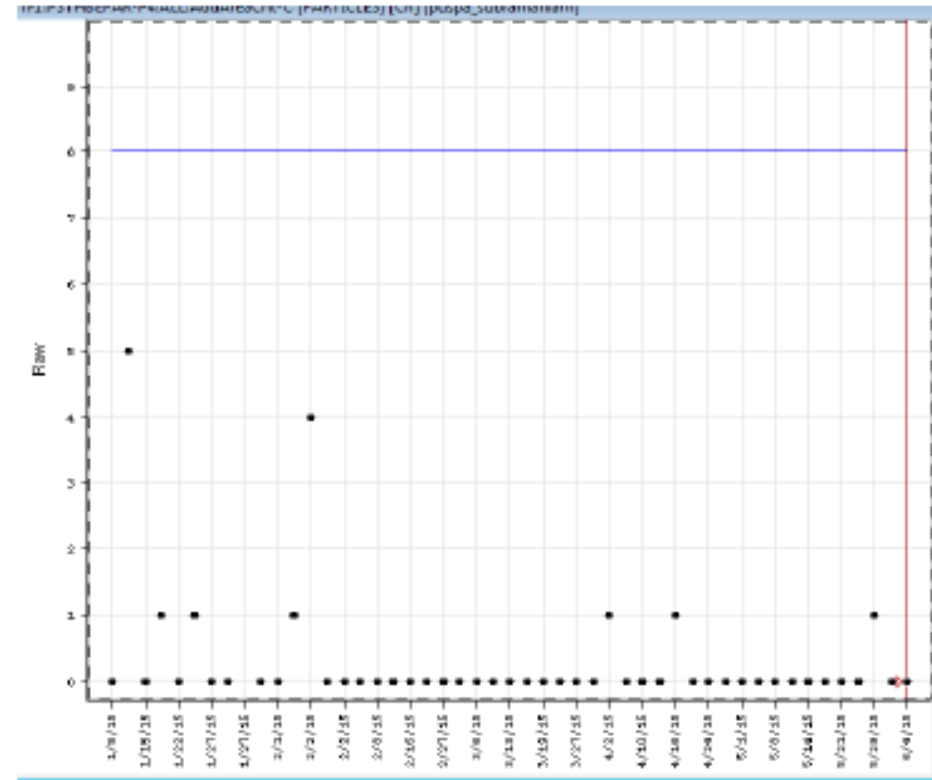




# Particle Data (6か月)



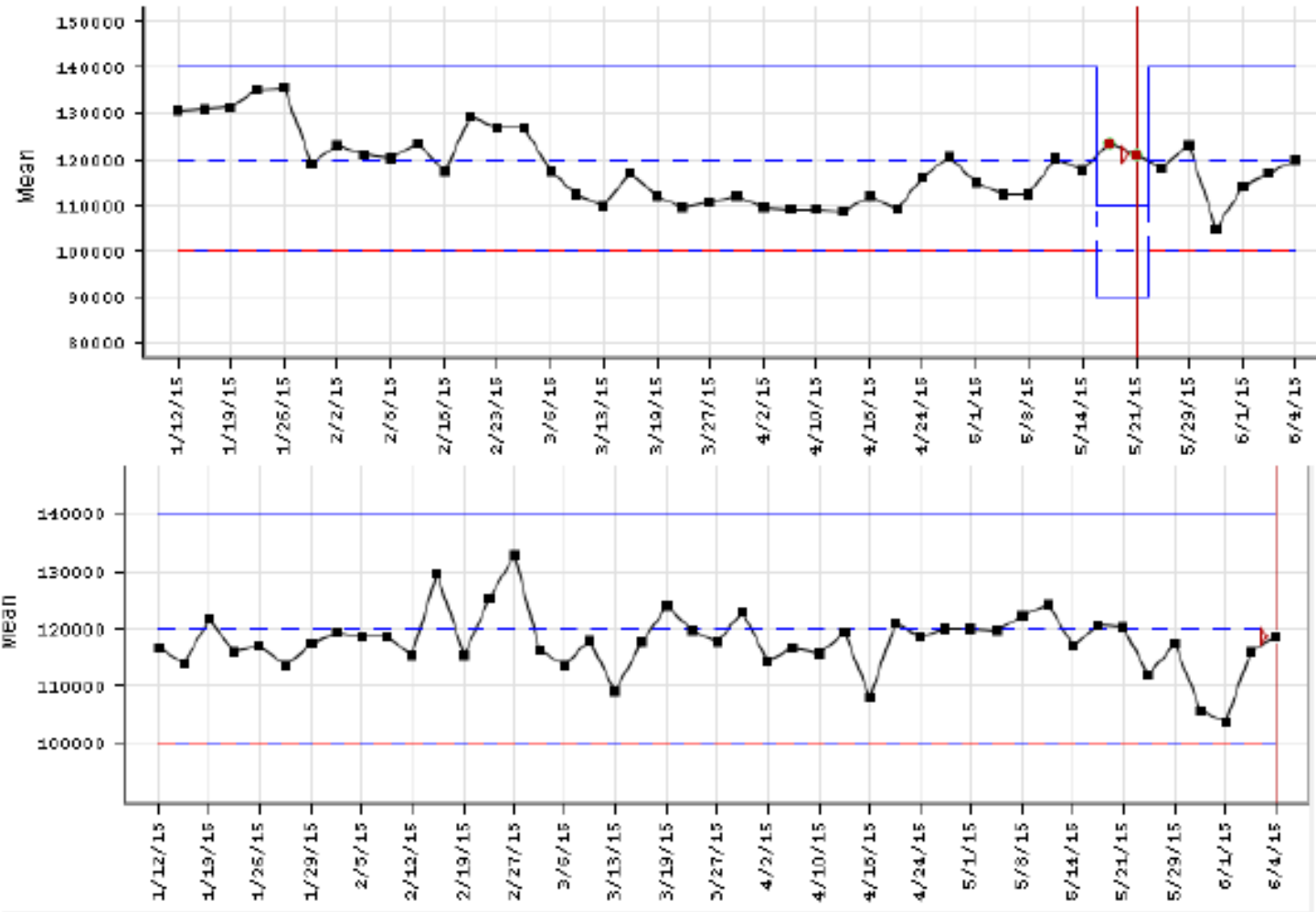
チャンバA



チャンバB

• Particle Performance: <3 adds @>0,12um

# 6か月PR除去データ



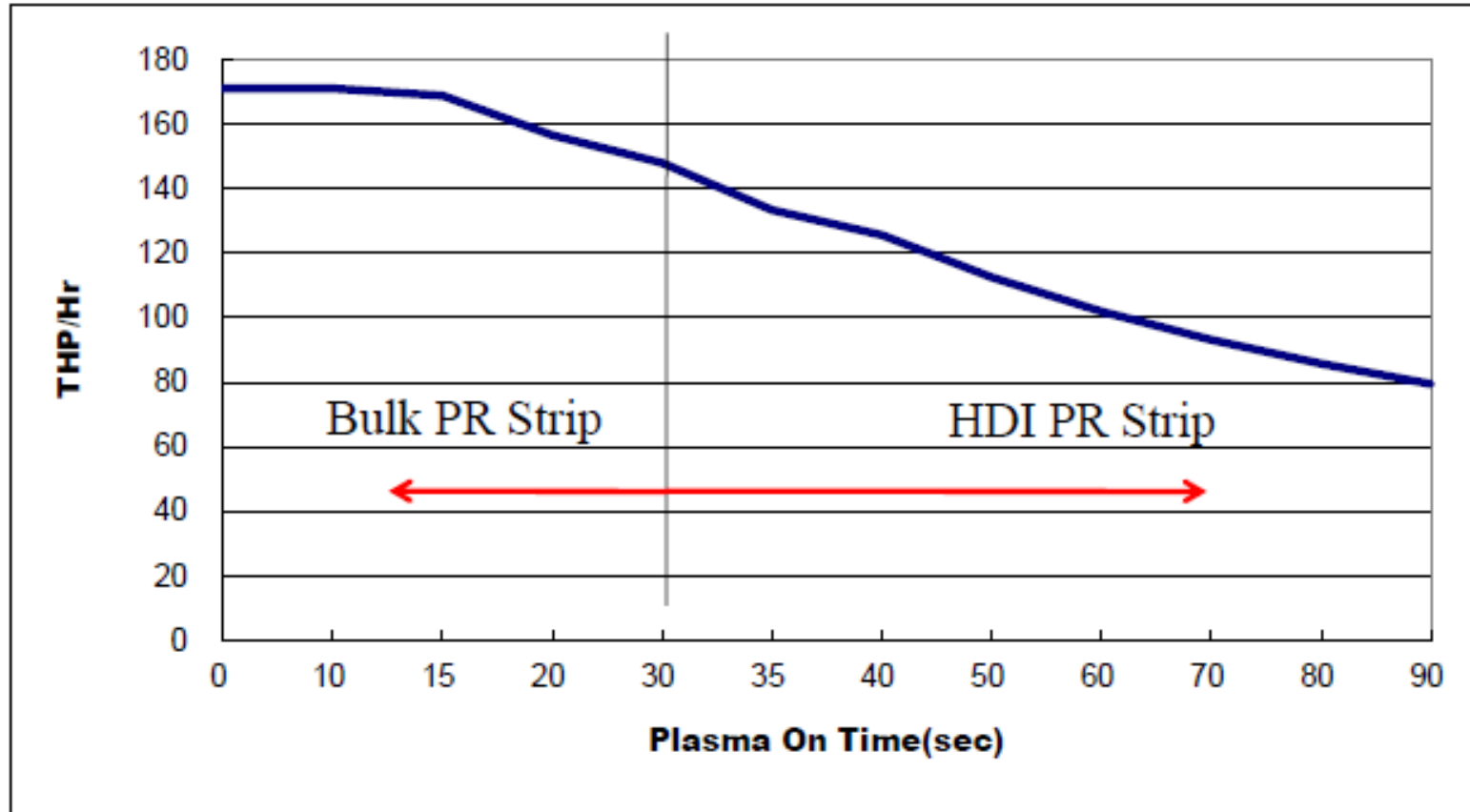
Chamber A

Chamber B

## 装置性能評価

要求条件	FX 200 Performance
PR除去レート (um/min)	≥10um/min
面内均一性 (+/-%)	≤±5
プラズマダメージ	None
MTBF	>400Hrs
MTBC	>100,000
MTTR	<3 hrs
Particle性能	< 5 ea @> 0.12um

# Through Put



(3チャンバ連続処理モード)